

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2023-057

上海新阳半导体材料股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	上海新阳	股票代码	300236
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李昊	张培培	
电话	021-57850066	021-57850066	
办公地址	上海市松江区思贤路 3600 号	上海市松江区思贤路 3600 号	
电子信箱	info@sinyang.com.cn	info@sinyang.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	551,752,184.59	549,498,135.81	0.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,805,323.87	9,911,470.51	775.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	52,952,332.45	52,472,861.43	0.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,593,344.54	-129,633,395.12	87.97%
基本每股收益（元/股）	0.2805	0.0318	782.08%

稀释每股收益（元/股）	0.2805	0.0318	782.08%
加权平均净资产收益率	1.96%	0.20%	1.76%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,918,906,087.04	5,620,352,673.68	5.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,491,120,978.21	4,113,567,347.16	9.18%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	44,532	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王福祥	境内自然人	14.37%	45,032,070.00	33,774,052.00		
上海新晖资产管理有限公司	境内非国有法人	11.88%	37,220,676.00		质押	3,130,000.00
上海新科投资有限公司	境内非国有法人	7.27%	22,788,086.00		质押	2,000,000.00
SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD	境外法人	4.09%	12,832,590.00			
孙慧明	境内自然人	3.48%	10,920,938.00			
金叶飞	境内自然人	1.69%	5,297,201.00			
杨燕灵	境内自然人	1.51%	4,721,700.00			
金叶玲	境内自然人	0.95%	2,992,290.00			
张朦	境内自然人	0.76%	2,382,084.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.67%	2,113,523.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	发起人股东王福祥、上海新晖资产管理有限公司、上海新科投资有限公司为关联公司，属同一控制人控制下的一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否有关联关系和一致行动人情况。					
前 10 名普通股股东	上海新晖通过普通证券账户持有 30720676 股，通过信用交易担保证券账户持有 6500000 股，实际					

参与融资融券业务股东情况说明（如有）	合计持有 37220676 股。孙慧明通过普通证券账户持有 1820939 股，通过信用交易担保证券账户持有 9099999 股, 实际合计持有 10920938 股。金叶飞通过普通证券账户持有 3282055 股，通过信用交易担保证券账户持有 2015146 股，实际合计持有 5297201 股。杨燕灵通过普通证券账户持有 53700 股，通过信用交易担保证券账户持有 4668000 股，实际合计持有 4721700 股。金叶玲通过普通证券账户持有 13700 股，通过信用交易担保证券账户持有 2978590 股，实际合计持有 2992290 股。张滕通过普通证券账户持有 4700 股，通过信用交易担保证券账户持有 2377384 股，实际合计持有 2382084 股。
--------------------	--

公司是否具有表决权差异安排

是 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	上海新晖、上海新科、王福祥、孙江燕、王溯
变更日期	2023 年 06 月 19 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网
指定网站披露日期	2023 年 06 月 19 日

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

报告期内，公司实现营业收入 5.51 亿元，较去年同期略有增长。实现归属于上市公司股东的净利润为 8,681 万元，同比增长 776%。公司半导体行业实现营业收入 3.39 亿元，同比增长 6.27%，集成电路制造用关键工艺材料系列产品收入稳定增长。其中，先进封装用电镀液及添加剂系列产品市场份额快速增长，集成电路制造用干法蚀刻后清洗液产品在客户端认证顺利，增长迅速。涂料业务受下游房地产市场及原材料价格大幅波动等不利影响，2023 年上半年实现营业收入 2.08 亿元，较去年同期下降 7.14%。

1、公司技术创新稳中有进

报告期内，面对产业快速发展及下游客户的深度合作，公司围绕核心业务技术，持续研发投入，创新产品，为客户提供整体化解决方案。报告期内公司研发投入总额 0.64 亿元，占本期营业收入的比重为 11.60%，主要集中于集成电路制造用光刻胶、先进制程清洗液氮化硅和氮化钛蚀刻液、化学机械研磨液等项目。

在集成电路制造用清洗液产品方面，28nm 干法蚀刻后清洗液产品已规模化量产，14nm 技术节点后干法蚀刻后清洗液也已量产并实现销售，公司干法蚀刻后清洗液产品已经实现 14nm 及以上技术节点全覆盖。本报告期干法蚀刻后清洗液产品销售规模不断扩大，广泛应用于逻辑电路、模拟电路、存储器件等晶圆制造客户。其中，铝互连干法蚀刻后清洗液长期受制于国外唯一原材料供应商限制，面对先进制程所需的配套材料亦需国产化的现状，公司自主研发攻关的“卡脖子”的关键原材料项目——非羟胺项目，已开发出满足晶圆制造企业要求的无羟胺干法蚀刻后清洗液产品，并在国内主流晶圆制造客户端通过验证，报告期内该项目产品的清洗能力不断提升。公司报告期内开发的钨残留去除液一次性通过客户测试验证，并取得订单，新产品的开发销售将不断拓展公司清洗液产品应用市场。在公司原创开发的蚀刻液产品方面，公司深入研究，做好前瞻性研究和技术储备，进一步扩大市场应用，引领行业发展，本报告期开发的新一代高选择比氮化硅刻蚀液已通过电性测试。

在集成电路制造及先进封装材料领域，随着芯片技术的向前发展，推动芯片朝着高性能（大功率、高算力）和轻薄化（体积/面积小）两个方向提升，芯片铜互连成为主流互连工艺技术。电镀系列产品——大马士革工艺、硅通孔工艺（TSV）、凸点工艺（Bumping）广泛应用，来实现金属之间的互联。公司电镀液及其添加剂是实现互联技术的关键工艺材料。经过多年的开发、技术储备，以及与客户紧密的合作，报告期内公司电镀液添加剂相关产品进展顺利，应用规模持续扩大。

在光刻胶及研磨液两大类产品方面，报告期内均取得了长足的进展与突破。其中，光刻胶项目研发进展比较顺利，I 线、KrF 光刻胶产品工艺性能指标不断优化，以满足客户的工艺需求，目前已在超 20 家客户端提供样品进行测试验证，报告期内光刻胶销量持续增加，同时原料开发工作也取得阶段性成果，

原料树脂的合成方案探索、工艺优化、稳定性等方面都取得突破。ArF 浸没式光刻胶的研发进展也比较顺利，已在国内多家晶圆制造企业开展测试验证工作，部分型号产品已取得良好的测试结果及工艺窗口，技术指标与对标产品比较接近。报告期内光刻胶系列产品已实现营业收入超百万元。在研磨液系列产品方面，公司的化学机械研磨液（CMP）已有成熟的 STI Slurry、Poly slurry, W slurry 系列产品在超过 10 余家客户端测试验证。本报告期已有多款产品通过客户测试，实现销售，进入批量化生产阶段。

公司多年来始终如一，坚持自主创新，充分挖掘自身潜力，与产业链上下游协同创新发展，坚定不移地围绕国家被“卡脖子”关键工艺材料产品，围绕公司核心技术持续突破，不断提升公司在集成电路制造用关键工艺材料领域的竞争力。

2、半导体业务规模持续扩大

半导体行业的发展对科技和经济发展存在重要意义。随着整个半导体产业的持续增长，以及中国大陆不断新建的代工产能，中国大陆半导体市场规模增速将会持续超越全球增速，成为全球最大的半导体材料市场。公司开发的集成电路制造用关键工艺材料产品仍然面临旺盛的市场需求。公司布局规划的清洗液、刻蚀液、电镀液及添加剂、光刻胶、研磨液等化学品材料产能不断加强完善，其中上海厂区年产能 1.9 万吨扩充目标已建设完成，合肥第二生产基地一期 1.7 万吨预计四季度投产，二期规划 5.3 万吨年产能相关手续正在办理中。为了进一步巩固在国内半导体材料行业的领先地位，根据市场需求及规模情况，公司与上海化学工业区管理委员会、上海化学工业区发展有限公司签订《投资意向协议》，启动位于上海化学工业区的项目建设，该项目主要用于开发光刻胶及配套材料产业化建设。随着公司在半导体业务产能方面布局的持续完善，公司产能规模的不断释放，能够满足未来市场需求的增长。

3、深化半导体气息

新阶段的新阳公司，始终围绕技术引领、产品引领、市场引领的战略目标，持续创新、创造，将公司打造成为半导体材料行业引领者。

2023 年上半年公司围绕“持续推进半导体气息”管理主题，一方面从企业运营着手，不断实践，不断优化完善管理体系，重点关注市场、供应链、质量管理、技术创新等方面工作，全力落实推进基础数据上线，数据互通、业财融合的系统改造升级任务，实现信息交互同步，优化交叉业务流程，以便满足未来集团战略管控需要，支持集团发展目标。

另一方面公司注重人才团队的培养建设和员工生活。随着公司业务规模的不断扩大，员工人数持续增加。截止报告期末，公司半导体业务板块人员净增 49 人，环比增长 10%。在人才团队建设方面，公司结合行业现状及公司发展规划，完善梯队建设，开展行业动态讲座，强化师徒带教的人才培养模式，为员工搭建职业发展、学习成长的平台，让员工与公司共同成长，持续进步。

在员工生活方面，公司通过持续开展“心温暖”民主对话会活动、半导体气息知识有奖问答活动、聚力凝心三峡团建活动、健身运动等等活动，关注员工生活、倾听员工心声、激发员工生活热情，提高员工企业文化认同感。

报告期内，公司完成了 2022 年度股份回购计划，回购公司股份 2,632,685 股，用于公司股权激励计划。2023 年上半年公司持续实施股权激励及员工持股的一揽子计划，践行薪酬证券化长效激励机制，实施了新成长（二期）股权激励计划及芯征途（二期）员工持股计划，持续与员工共享公司发展红利，提升员工在企幸福指数。未来公司还会持续推行薪酬证券化的长效激励机制，不断吸引、聚集优秀人才，为公司未来长期稳定的可持续发展提供强有力的人才保障。

通过各项“深化半导体气息”工作的不断开展，目标是增强公司的生存成长能力和行业影响力，提升每一位员工的个人品格魅力和职业素养，最终实现企业竞争力的全面提升。

4、积极推动涂料业务板块独立挂牌

报告期内，子公司江苏考普乐股份制拟申请在新三板挂牌的项目正常推进过程中，公司子公司在保荐机构、律师事务所、会计师事务所等中介机构协助下逐步开展股份制改制、融资、申请在新三板挂牌的相关工作，目前江苏考普乐公司已完成股份制改革，注册资本已增资扩大到人民币 6,231.8 万元。

公司积极推动控股子公司江苏考普乐独立挂牌、进入创新层项目，助力其进一步完善其法人治理结构，拓宽融资渠道，稳定和吸引优秀人才，促进规范发展，增强核心竞争力。同时公司本部能够集中资源发展半导体业务，有利于上市公司总体经营战略的实施，实现上市公司整体效益最大化。

上海新阳半导体材料股份有限公司

2023 年 08 月 23 日